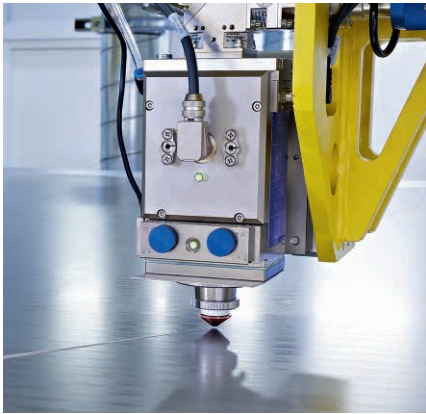


PLATINENSCHNEIDEN MIT LASER. ES WERDE LICHT.



Laserkopf.



Achtung Laser!

ZIELSETZUNG

Um das volle Potenzial heutiger Laserschneidsysteme zu nutzen, ist das Grundverständnis dieser Technologie wichtig. Im Verlauf dieses Seminars erfahren Sie die Unterschiede verfügbarer Lasersysteme, deren Wirkprinzip und im speziellen den Einsatz eines Faserlasers am Beispiel des Platinenschneidens.

Anhand von einer Vielzahl von Beispielen werden die theoretischen Hintergründe verständlich aufbereitet.

INHALT

- Laser – was ist das?
- Erzeugung von Laserstrahlen
- Was ist nötig, um Laserstrahlung nutzbar zu machen
- Systeme in der Produktionslandschaft
- Schneidprozesse und die notwendigen Rahmenbedingungen
- Beispiel einer Anlagenkonfiguration zum Platinenschneiden
- Möglichkeiten und Grenzen heutiger Lasermaterialbearbeitung
- Sicherheit im Kontext der Laserstrahlung
- Technologie-Update

ZIELGRUPPE

- Leiter von Funktionseinheiten aus dem Bereich der Anlagentechnik
- Anwender und Entscheider aus dem Bereich Produktion und Instandhaltung
- Anlagenbediener
- Instandhalter Mechanik
- Instandhalter Elektrik
- Einrichter
- Werkzeugmacher
- Planer/Optimierer
- Mitarbeiter der Fertigungs- und Presswerkplanung
- Technischer Einkäufer

TRAINER

Andreas Schmidt

VORAUSSETZUNGEN

Seminar GPS Platinen Schneidsysteme – Grundlagen

TERMINE/ORT

16.05.2019
Automation TechCenter
Heßdorf

21.11.2019
Automation TechCenter
Heßdorf

✉ Individuelle Termine auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09.00 – 16.30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

650,- Euro pro Person
zzgl. MwSt.

ANSPRECHPARTNERIN

Pia Stier
Telefon +49 7161 66-7721
pia.stier@schulergroup.com

ANMELDUNG

Seminarnummer: GPL | Dieses Seminar kann auch als Teil des Pakets 4 gebucht werden. Mehr Infos auf Seite 11 oder unter www.schulergroup.com/Forming_Academy.